

# 技術資料

## EP-2005 絕緣接著劑

### 產品說明：

**EP-2005** 為單液型環氧樹脂晶片接著劑，主要應用於 Flex-BGA & stacked-die BGA 封裝，可快速硬化，並具有良好之韌性、不溢流及對於不同基板皆有良好黏著性。

### 產品特徵：

- 平滑、流體且不拉絲之銀膠。
- 低揮發物、不溢膠。
- 低應力。
- 改善 MSL 測試之信賴性。

硬化前特性		測試條件	測試方法
比重	1.4 g/cc	比重計	FT-P001
外觀	紅色		
黏度 @ 25°C	8500 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	5.5	Brookfield DV-III/CP-51 黏度. @ 0.5rpm/黏度 @ 5rpm	FT-P008
水含量	< 0.5 %	水份計	FT-P002
使用壽命 @ 25°C	48hrs	黏度升高 25% @ 5rpm	FT-P024
保存期限 @ -40°C	6 個月		FT-P018
烘烤條件		測試條件	測試方法
標準烘烤條件		60 分鐘 @ 150°C (烘箱烘烤)	
硬化時之熱重損失	<5%		FT-P010
機械性質		測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C	14.0 kg/die	晶片尺寸 2mm × 2mm (銀支架)	FT-M012
@ 260°C	2.2 kg/die		

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

## EP-2005 絕緣膠

物理及化學性質		測試條件	測試方法
重量損失@200°C	0.1%	熱重分析儀	FT-P010
玻璃轉移溫度 (Tg)	47°C	DMA 阻尼峰,三點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數	<Tg 33ppm/°C >Tg 155 ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
儲存模數			
@60°C	4532MPa		
@25°C	1694MPa	DMA, 試片厚度<1.6mm	FT-M019
@150°C	101MPa		
@250°C	107MPa		
離子含量			FT-C021
鈉	0.2ppm	Teflon 樣本瓶, 20~40mesh	
鉀	Not detected	5g 樣品, 50g 去離子水	
氯	19.6ppm	24hrs@100°C	
水份含量	<0.5%	水份計	FT-P002

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。